

高性能 玻璃載片 – 適用於半導體應用

數十年來，首德在高品質玻璃晶圓載片和玻璃面板方面建立了無與倫比的聲譽，為半導體、光電、汽車、科學和生物科技等高科技產業提供多樣化的產品。我們的專家提供寶貴的支援，開發量身打造的解決方案，以滿足客戶的特定需求。

我們的玻璃載片在先進半導體應用中扮演著重要的角色，可作為矽晶圓和晶片的臨時貼合和解貼合基板。首德玻璃從紫外光到紅外光的高光學透射率可實現高效率的雷射輔助解貼合，並支援多種先進封裝解決方案。

隨著半導體結構變得越來越複雜，對於穩定、超薄載片材料的需求也持續成長。玻璃晶圓和面板越來越多地被用於以下應用：

- 3D IC (3D 積體電路)
- IGBT (絕緣閘雙極電晶體)
- 扇出式晶圓級封裝 (FOWLP) 與面板級封裝 (FOPLP)



高品質玻璃原料



廣泛的產品組合



多種產品形態



貼合與解貼合



可用於後段製程

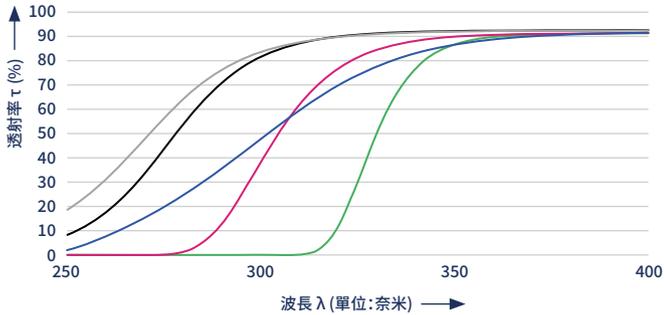
為什麼選擇 SCHOTT 玻璃載片？

- 專為半導體製程設計
適用於臨時貼合、矽晶圓減薄和扇出式封裝
- 無與倫比的精度
超低的總厚度變化 (TTV) 和最小的翹曲可確保最高的製程穩定性
- 出色的光學特性
從紫外光到紅外光的優異穿透性，可進行先進的雷射與光學製程
- 卓越的耐化學性
高度耐酸、耐鹼及耐水解，可提高耐用性
- 廣泛的 CTE 範圍
廣泛的材料選擇，確保與不同元件基板的最佳熱膨脹匹配
- 製程就緒設計
雷射標示、無塵室包裝的晶圓和面板，適用於高科技製造
- 嚴格的業界標準與無塵室處理
 - 平面/缺口：符合 SEMI 標準
 - 雷射標示：符合 SEMI 標準
 - 清洗：在 ISO 5 無塵室進行超音波/微波清洗
 - 包裝：在 FOSB、RTU 晶圓盒中進行 ISO 5 條件下的檢查與包裝
- 多樣化的加工選項
提供最先進的加工能力，以滿足載片晶圓和面板的各種半導體需求。
- 專業技術
我們的專家提供量身訂做的支援，協助客戶找到最適合其應用的載片材料

玻璃載片

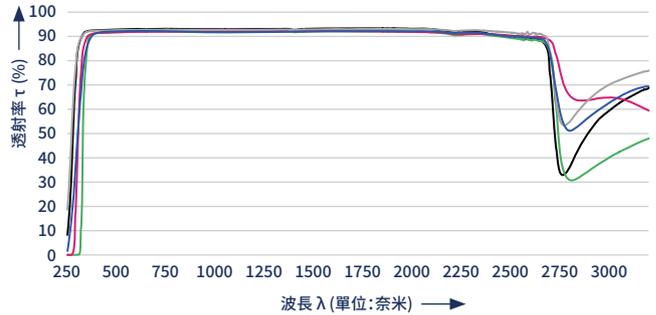
我們的玻璃載片晶圓和面板以高品質的加工技術著稱

光譜透射率 $\lambda = 250$ 奈米至 400 奈米



— 0.7 mm 的 SCHOTT® AF 35 G — 1.1 mm 的 D 263™ T eco — SCHOTT B 270™ 1.1 mm
 — 1.1 mm 的 BOROFLOAT® 33 — BOROFLOAT® 41, 厚度 0.7 mm

光譜透射率 $\lambda = 250$ 奈米至 3,200 奈米

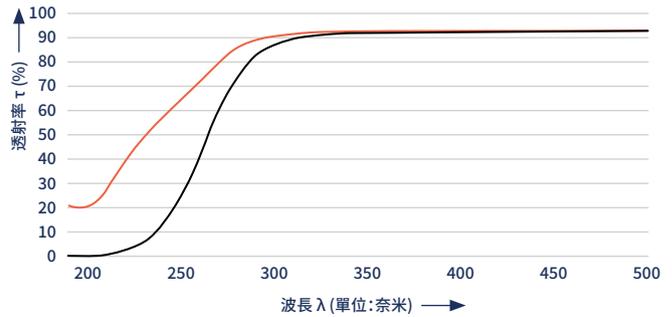


— 0.7 mm 的 SCHOTT® AF 35 G — 1.1 mm 的 D 263™ T eco — SCHOTT B 270™ 1.1 mm
 — 1.1 mm 的 BOROFLOAT® 33 — BOROFLOAT® 41, 厚度 0.7 mm

項目	晶圓	面板
格式*	6", 8", 12" [150 - 300 公釐]	最大 650 x 650 mm
厚度	0.4 - 3.0 mm	0.25 - 1.75 mm
總厚度變化 (TTV)	≤ 2.0 μ m (標準) ≤ 0.5 μ m (進階)	≤ 20 μ m (標準) ≤ 15 μ m (進階)
精確厚度公差	± 5.0 μ m (標準) ± 2.5 μ m (進階)	± 20 μ m (標準) ± 10 μ m (進階)
翹曲	12": ≤ 50 μ m 8": ≤ 30 μ m	≤ 200 μ m (標準) ≤ 100 μ m (進階)
外觀品質	40/20 (標準)	40/20 (標準)
刮痕/凹痕	20/10 (進階)	20/10 (進階)

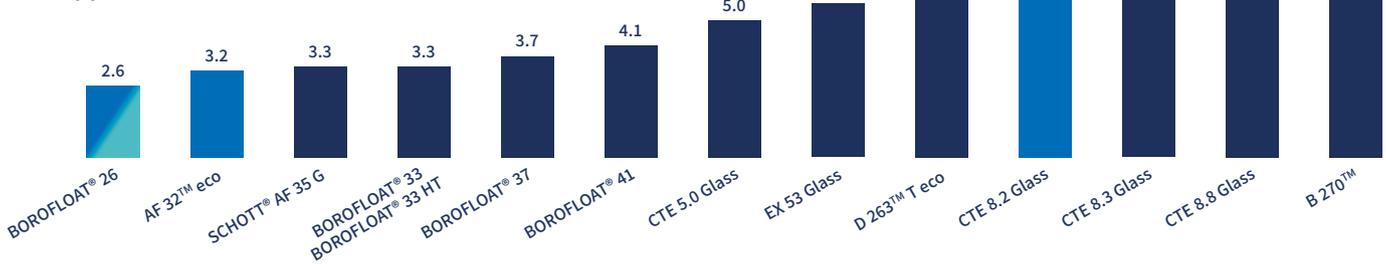
* 其他尺寸請洽詢

光譜透射率 $\lambda = 200$ 奈米至 500 奈米



— BOROFLOAT® 33 HT — BOROFLOAT® 33

CTE (ppm/K)



- 開發中, 可提供晶圓和面板樣品
- 可提供晶圓和面板
- 僅提供晶圓



CHINESE/TW 03/2025 kn/nino Printed in Germany

schott.com

台灣首德股份有限公司a, 台北市南京東路四段126號8樓之3
 電話 (02) 2570-9626, 傳真 (02) 2570-9628, 電子信箱 info.special-glass-wafer@schott.com

SCHOTT
 glass made of ideas